



2014年1月16日

最新发布

AKROMETRIX宣布推出对流加热回流焊炉仿真模组做为下一代回流焊模拟，结合表面特性分析。

高温表面特性技术的领导者Akrometrix LLC，宣布推出了实用的对流回流焊炉仿真模组（CRE），是结合TherMoiré AXP软件平台Studio的下一代附加模组。CRE模组回应了半导体工业表面量测最高解析度的需求，同时利用对流加热方法有效的模拟了回流焊过程，优化了样品顶端/底部温度的均温性。

CRE模组加强了Akrometrix 工业标准的shadow moiré量测技术，提供了Z方向的解析度从2.5微米降到次微米级别的解析度。CRE模组是基于TherMoiré平台可扩展的第四代附属模组。

根据Akrometrix销售和业务发展部副总裁David Markovich所说：“微电子工业驱动了更精密的机械规格，比如有着紧密互连的超薄器件，需要很高的共面性量测解析度以及最理想的回流的模拟，目的是为了充分的了解电子器件在不同的组装温度下动态的翘曲情况。

使用CRE模组收集的翘曲结果，可以继续使用Akrometrix的Interface Analysis软件来与对应的PCB/基板的翘曲数据做结合，由此可以在回流焊过程中的关键性温度下进行形状匹配及间隙分析。

CRE模组的推介代表了Akrometrix 向满足客户需求以及提供解决方案的承诺。CRE模组在2014年4月可以交付。

高温表面特性的领导者Akrometrix LLC，由Dr. Charles Ume在1993年成立，他是乔治亚州首府亚特兰大，乔治亚理工学院乔治·w·伍德拉夫机械工程学院先进电子封装和镭射加工实验室的主管及教授，总部位于亚特兰大。Akrometrix全球范围安装有超过250台的设备。